

R-Car Proactive Partner Solution

DRAM & Flash Solution

ウィンボンド・エレクトロニクス株式会社



概要

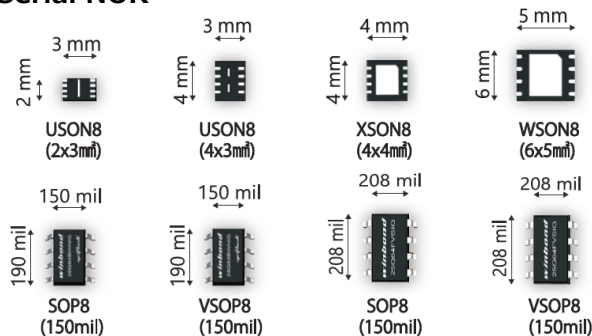
Winbond は、外部メモリを必要とする R-Car ファミリに適した NOR フラッシュ、NAND フラッシュ、DRAM を含むトータル・メモリ・ソリューションを提供します。

主な機能

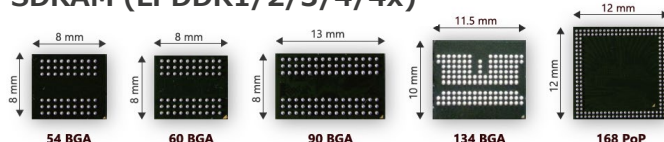
- Serial NOR: Quad / Octal SPI, 2Mb~2Gb, 1.8V and 3.3V, 100K cycles endurance
- Serial NAND: Quad / Octal SPI, 512Mb~4Gb, 1.8V and 3.3V, 100K cycles endurance
- ONFI NAND: ONFI 1.0, 1Gb~8Gb, 1.8V and 3.3V, 100K cycles endurance
- SDRAM: DDR1/2/3/4 64Mb~8Gb, LPDDR2/4/4x 512Mb~8Gb
- HyperRAM™: HyperBus, 32Mb~512Mb, 1.8V

ンブロック図／ダイアグラム

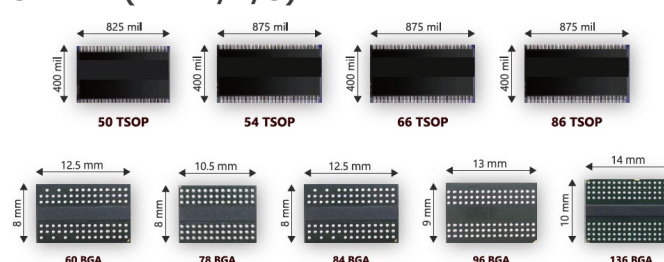
Serial NOR



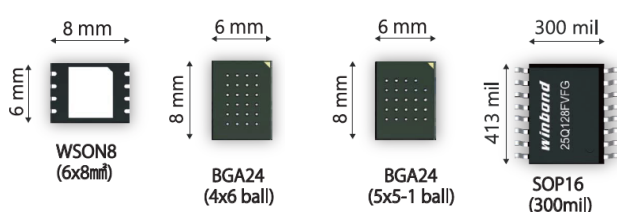
SDRAM (LPDDR1/2/3/4/4x)



SDRAM (DDR1/2/3)



Serial NOR & Serial NAND



ターゲット市場及び用途

- Instrument Cluster
- ADAS
- V2X
- Telematics
- Gateway
- BMS

https://www.winbond.com/hq?_locale=ja



先進的なメモリ製品の信頼できるサプライヤ

研究開発から高度な製造・顧客サービスまで、ウィンボンド・エレクトロニクス株式会社はメモリ・ソリューションのトータル・プロバイダーです。

ウィンボンドの製品ポートフォリオは、DRAM、コード格納用フラッシュメモリ、および TrustME®セキュア フラッシュ メモリで構成されています。同社は、通信、家庭用電化製品、自動車、産業機器、コンピュータ周辺機器の顧客に、直接または認定代理店の世界的なネットワーク経由で製品を供給しています。

ウィンボンドの本社は台湾中部のサイエンスパークにあり、台中市と高雄市でウェハ製造工場を運営しています。米国、日本、イスラエル、中国、香港、ドイツの子会社が、顧客に直接サポートを提供します。

ウィンボンドは、自社開発した高度な半導体技術と顧客との緊密な関係の組み合わせにより、メモリ製品の信頼できるサプライヤーとしての地位を支えています。

Company Name	Winbond Electronics Corporation
Date of Establishment	1987-09-29
Chairman	Arthur Yu-Cheng Chiao
Vice Chairman	Thung-Yi Chan
President	Pei-Ming Chen
Capital Stock	39.8 billion Taiwan dollars (as of October 2020)
Number of employees	3048 (as of October 2020)
Headquarters Location	No. 8, Keya 1st Rd., Dayu Dist., Central Taiwan Science Park, Taichung City 42881, Taiwan
Overseas Branches	USA, Japan, Israel, China, Hong Kong, Germany

